

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Pin	DIM A	DIM B	DIM C
2	6.00	2.00	4.90
3	8.00	4.00	6.90
4	10.00	6.00	8.90
5	12.00	8.00	10.90
6	14.00	10.00	12.90
7	16.00	12.00	14.90
8	18.00	14.00	16.90
9	20.00	16.00	18.90
10	22.00	18.00	20.90
11	24.00	20.00	22.90
12	26.00	22.00	24.90
13	28.00	24.00	26.90
14	30.00	26.00	28.90
15	32.00	28.00	30.90
16	34.00	30.00	32.90

A

B

C

D

E

F

G

A

B

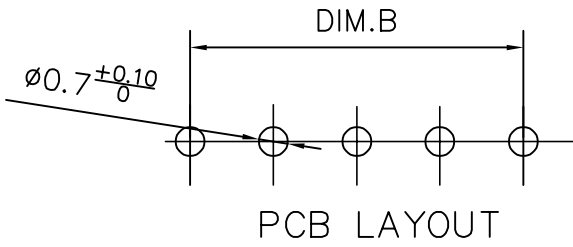
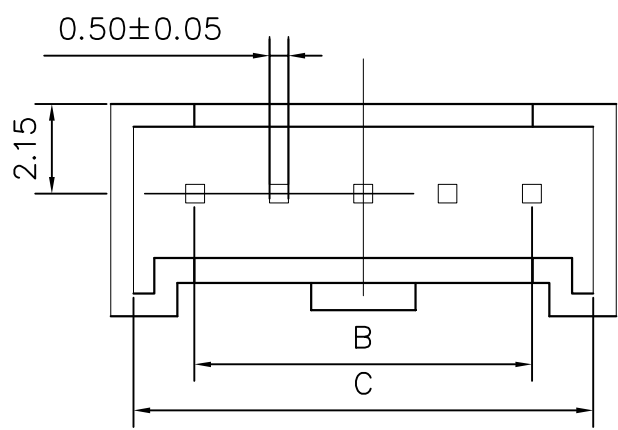
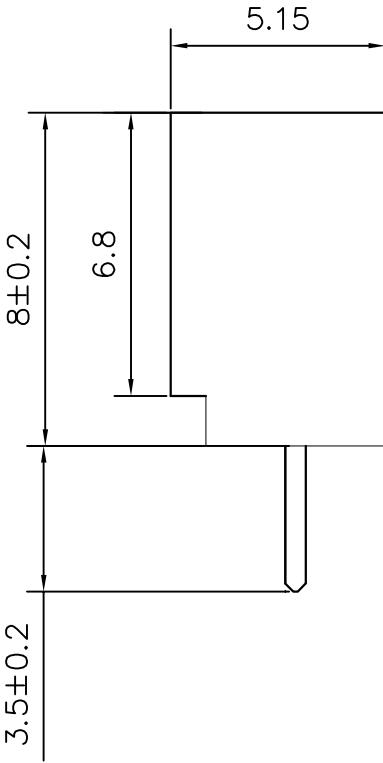
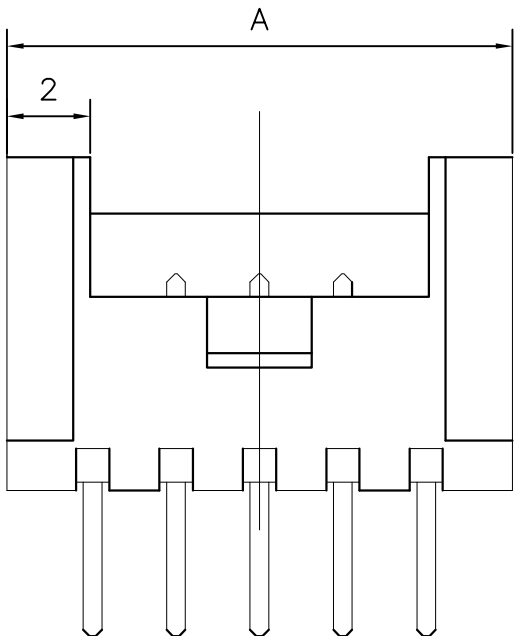
C

D

E

F

G



技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 250V AC/DC
额定电流: 1A
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐 压: 800V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

针座

料 号
PART NO

HC-HY2. 0-10A-M

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

